

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年3月5日(2015.3.5)

【公開番号】特開2013-187313(P2013-187313A)

【公開日】平成25年9月19日(2013.9.19)

【年通号数】公開・登録公報2013-051

【出願番号】特願2012-50719(P2012-50719)

【国際特許分類】

H 05 K 1/02 (2006.01)

H 05 K 3/24 (2006.01)

H 05 K 3/18 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/02 Q

H 05 K 1/02 F

H 05 K 3/24 A

H 05 K 3/18 N

【手続補正書】

【提出日】平成27年1月15日(2015.1.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

絶縁基板と、

前記絶縁基板の一方の面に形成される配線層と、

前記絶縁基板の一方の面と他方の面との間を貫通する第1貫通孔内に形成され、前記配線層に接続される第1ビアと、

前記配線層及び前記第1ビアから離間して前記絶縁基板の一方の面に形成されるバスラインと、

前記絶縁基板の一方の面と他方の面との間を貫通する第2貫通孔内に形成され、前記バスラインに接続される第2ビアと

を含む、配線基板。

【請求項2】

前記絶縁基板の他方の面側において前記第1ビア及び前記第2ビアを電気的に接続した状態で前記バスラインに給電を行うことによって前記配線層の表面に形成される、めっき層をさらに含む、請求項1記載の配線基板。

【請求項3】

前記絶縁基板の一方の面には、前記配線基板を個片化した後の複数の配線基板片に対応し、それぞれに前記配線層が形成される配線形成領域が複数設けられており、

前記バスラインは、前記複数の配線形成領域の周囲を囲むように設けられている、請求項1又は2記載の配線基板。

【請求項4】

前記配線層及び前記第1ビアと、前記バスライン及び前記第2ビアとは、互いに電気的に分離されている、請求項1乃至3のいずれか一項記載の配線基板。

【請求項5】

一方の面に配線層が形成されるとともに、前記一方の面と他方の面との間を貫通する第

1 貫通孔内に前記配線層に接続する第1ビアが設けられた絶縁基板の、前記他方の面において、前記第1ビアに金属シートを当接させる工程と、

前記金属シートを介して前記第1ビア及び前記配線層に給電を行う電解めっきにより、前記配線層の表面にめっき層を形成する工程と

を含む、配線基板の製造方法。

【請求項6】

前記絶縁基板は、前記配線層及び前記第1ビアから離間して前記一方の面に形成されるバスラインと、前記一方の面と前記他方の面との間を貫通する第2貫通孔内に形成され、前記バスラインに接続される第2ビアとをさらに含んでおり、

前記第1ビアに金属シートを当接させる工程では、前記金属シートは前記第2ビアにも当接されており、

前記めっき層を形成する工程は、前記バスラインに給電を行うことにより、前記第2ビアを介して前記金属シートに給電を行いながら、前記配線層の表面にめっき層を形成する工程である、請求項5記載の配線基板の製造方法。

【請求項7】

前記配線層の表面にめっき層を形成する工程は、前記金属シートに給電を行いながら、スパージャ方式で、前記配線層の表面にめっき層を形成する工程である、請求項5記載の配線基板の製造方法。

【請求項8】

前記配線層の一部を端子として露出する絶縁層を前記配線層の上に形成する工程をさらに含む、請求項5乃至7のいずれか一項記載の配線基板の製造方法。